(9) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56—106223

⑤ Int. Cl.³G 02 F 1/17G 09 F 9/00

識別記号

庁内整理番号 7267—2H 7129—5C 砂公開 昭和56年(1981)8月24日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

匈エレクトロクロミツク表示装置の製造方法

願 昭55-9550

②出 願 昭55(1980)1月29日

②発 明 者 高藤裕

②特

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

@発 明 者 矢野耕三

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ株式会社内

70発 明 者 武宏

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

⑫発 明 者 井波靖彦

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ株式会社内

@発 明 者 上出久

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ株式会社内

の出 願 人 シャープ株式会社

大阪市阿倍野区長池町22番22号

邳代 理 人 弁理士 福士愛彦

明 細 書

1. 発明の名称

エレクトロクロミツク表示装置の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 表示電極上のEC物質に該EC物質と選択的に除去可能な薄膜を積層し、該薄膜上にレジストを形成してエツチングにより前記EC物質をパターン形成した後前記EC物質の保護絶縁膜を被覆し、リフトオフ法を用いて前記EC物質上の前記保護絶縁膜を除去したことを特徴とするエレクトロクロミック表示装置の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は、ECD(<u>E</u>lectro<u>c</u>hromic <u>D</u>isplay)のEC物質を保護膜で被覆することにより特性を改善する技術に関するものである。

まず、ECDについて簡単に説明する。

E C D には大別して 2 種類あり、 1 つは表示セルに封入した溶液中の E C 物質に配気化学的酸化還元反応を行なわせ、着色不溶の反応物質を陰極上に生成させるものである。 このタイプの E C D

に用いられる溶液の材料としては、たとえば、EC 物質としてはヘプチル・ビオロゲン・ブロマイド、 支持電解質として臭化カリウムを用いた水溶液が 使われる。

もう1つは、無機固体膜と電解液を用いるものである。無機固体膜としては無定形酸化タングステン、電解液としては過塩素酸リチウム(LiCeO4)を溶かしたアーブチロラクトン等が用いられる。無機固体膜側を対向電極に対し負電位にすれば、無機固体膜は着色する。また、どちらのECDも、印加電圧極性を逆にすれば、着色は消去される。

ECDの特徴としては、

- 1) パッシブディスプレイである。
- 2) 駆動電圧が低い。
- 8) 書き込み(着色)電圧を除去した後も、回路を開放にしておけば、数時間~数日間着色が維持されるというメモリ特性を有する。このメモリ維持は、外部から電力を加える必要はない。
- 4) 視角が広い。
- 5) 多色化が可能。

(2)

- 特開昭56-106223(2)
- 6) 消費エネルギは書き込み~消去のサイクル数 に比例して増加する。杏き込み-消去の1サイ クルに消費されるエネルギは数~数十丁/dl で、 基板 1 , 7とを接着する接着剤である。
- · 7) 着色濃度は、ECD中に流れた電荷量により 一義的に決まる。

以上のような特徴を持つECDは、各種表示へ の応用が期待されている。

第1図に無機固体膜を用いた従来のECDを示 ・ す。図中1は表示側となる表示用透明基板、2は 透明基板1上に形成した表示用透明電極である。 3は印加電圧により着色、消色をする表示用無機 固体膜である。最も一般的に用いられる無機固体 膜は無定形酸化タングステン(WO3)である。 4 は 表示用透明基板 1 と背面基板 7 とを一定の間隔に 保つスペーサである。5は電解液で硫酸とグリセ リンの混合溶液に硫酸パリウムなどの白色粉末を 分散させたものが、たとえば用いられる。硫酸バ リウムは表示の背景となる白色を与えるものであ ・る。 6 は背面基板 7 上に形成された対向電極であ

(3)

SiO,SiO2,A&2O3,MgF2等の透明絶縁膜で 表示部以外の透明電極を被覆し、保護するために 種々の構造が提案されてきた。これらの例を第2 図(a)(b)(c)に示す。(a)の例は基板1上の透明導電膜 をパターン化し、透明電板2とした後、この上に マスク蒸着により SiO, SiO2, Al2 O3 等の絶縁 膜9を形成し、次KEC物質例えばWO3を絶縁膜 9に少しかぶさるようにマスク蒸着して表示電極 3を作る。この場合には着色したEC物質の膜 (以下EC膜と略配する)の脱色をする場合に、 絶縁膜9の上のEC膜部分(()が脱色し難いという 欠点がある。(b)の側は基板1の上の透明導電膜を パターン化し、透明電極2とした後この上にマス ク蒸着によりEC膜3を付着せしめ、表示電極と し、次にEC膜3の端に少し被さるように絶縁膜 9をマスク蒸着法で形成するものである。この場 合には着色したEC膜の脱色をする時向で示され た絶縁腹9の下の部分のEC膜が脱色し難いとい う欠点がある。(c)の例は基板 1 上の透明導電膜を パターン化し、透明電極 2 とした後、この上にマ

る。?は表示側透明基板1とともにECD表示セ ルを形成する背面基板である。8はスペーサ4と

上記のECDを書き込み(着色)状態にするに は、表示用透明電極2を対向電極6に対して負電 位にすればよい。表示電極2上に形成された表示 用無機固体膜3は、たとえば無定形酸化タングス テン(WO3)を用いた場合は背色に着色する。また、 印加電圧極性を逆転させれば、前記表示用無機固 体膜 8 は消色し、もとの無色透明状態に戻る。

上記のようなECDを実際に製造する場合、表 示部の引き出し部分の透明導電膜を電気化学的に 絶縁する必要がある。もしての絶縁がなされてい、 ない場合には、透明導電膜が酸化あるいは違元さ れ、長時間の動作の後には着色あるいは断線する。 また動作電圧を上げると透明導電膜で作られた引 き出し部と、対向電極との間に電流が流れ電力の 相失を生じる。

上記の理由により透明電極を保護するために真 空蒸着,スパツタあるいはCVD等の方法により

スク蒸着により絶縁膜9を形成し、次に絶縁膜に 少し被さるように透明電極2と同じ物質2を表示 パターンの形にマスク蒸着し、連続してその上に 同一のマスクによりEC物質3を蒸着する。この 場合はイイ)で示された絶縁膜上のEC層等の多層構 造である部分が目立ち、脱色時の見ばえが悪くな る。また動作を繰り返す事により、(1)の部分が脱 色し難くなり、見ばえが非常に悪化するという欠 点がある。

以上に述べた欠点を取り除くために第 8 図(a)~ (f)で示された方法が特額昭 52-61915号(昭 和52年5月26日出願)にて出願されている。 これは第3図(a)のように基板「上に透明導電膜2 その上にEC膜3を積層し、続いて第3図(b)に示 されたように透明導電膜2とEC膜3を同時にエ ツチングしてパターンを形成し次に第3図(c)に示 されたように、所望の表示パターンの形にレジス ト層をスクリーン印刷,あるいはフォトリソグラ フィにより形成し、続いて第3図(d)に示されるよ うにレジスト層下のEC膜のみを残し、不要な部

特開昭56-106223(3)

えが良くまた、見ばえの悪化が起きないECDの表示電極形成法を提供することを目的とするものである。

以下、本発明に係る表示電極の構造及び形成法 を実施例に従つて第4図(a)~(h)を用いて詳細に説 明する。

第4図(a)で示す如く、まず基板 I の上に In2 O3あるいは SnO 2 を真空蒸着等の方法により付着させエッチングによりパターン化し透明電極と形成する。次に第4図(b)に示すように透明電極上に真空蒸着あるいはスパック等の方法により E C 物質の膜、例えば W O3を約500 A 積層し、その上で と 機関的に除去が可能な物質を2000~500 A 程度の時まが可能な物質を2000~500 A 程度がメートのパターンにスクリーン開発ではカントのパターンにスクリーンの説法でレジスト層で形成はよりレジスト層の下の部分以外のに示されるようにレジスト層の下の部分以外の

(8)

本発明は、このようなレジストによるEC膜の 劣化を無くし、かつ、第2図(a)~(c)の構造におい て生じた絶縁膜とEC膜との重なり部における部 分的に着色し難い,あるいは脱色し難いという現 象により見ばえが悪化する事を解消し、長期にわ たつて応答時間が早く、安定に動作し、かつ見ば

(7)

WO3をKOH水溶液でエツチングして除去する。次 に第4図(イ)に示されるように、基板を十分水,メ タノールで洗浄し、続いてSiO2層を 6000Å程 度、真空蒸着あるいはスパッタにより形成する。 次に第4図(g)に示されるように、レジストを溶か す溶媒、例えばアセトン,トリクロルエチレン等 により超音波洗浄にかけると、レジストと共に、 レジスト上の SiO2 層は取り除かれる。 最後に図 4 (h)に示されるように、希硫酸の水溶液に没すと、 保護膜の層は直ちに溶解し、所望のパターンを有 し、WO3とSiO2等の絶縁膜との重なりがなく、 またWO3と絶縁膜の間隙の無いECD表示電極が 形成される。第 5 図(a) ~ (d) に第 4 図で示した方法 でECDを構成した場合の初期応答特性と第3図 で示した方法でECDを構成した場合の初期応答 特性とを示す。第5図(a)は従来の第8図に示した 方法でECDを作つた場合の初期の書き込み時間 の分布を100個以上のECDセルに対してとつ たものを示し、第5図(b)は第8図に示した従来の 方法で作られたECDセルの脱色時間の分布を示

す。また第5図(c)は第4図に示した本発明による 方法でECDセルを形成し100個以上のセルに 対してとつた初期書込み時間の分布を、また第5 図(d)は本発明による方法で作られたECDセルに 対する脱色時間の分布を示す。尚、これらのECD セルは全て対極にWO3,電解液はLiCeO4をプロ ピレンカーポネイトに溶解したものを用いた。第 5 図(a)~(d)より明らかなように本発明による表示 電極形成法を用いた場合に初期特性における書込 み時間,脱色時間のいずれも顕著に改善されてい る事がわかる。また室温で 6mc/ofの書き込み電 荷量で10°回ON-OFFを繰り返した後も第3図 で示された従来の方法で作られたECDセルの場 合著しく応答時間が長くなる(2~5倍)。しか しながら、本発明の方法により表示電極を形成し た場合、応答時間は初期値とほとんど変わらない。

以上のように本発明によれば、EC膜と絶縁膜の重なり部分がなく、また透明導電膜が電界液に対して露出する部分もない理想的な電極構造が得られ、かつ、EC層がレジスト等の影響を受けて

劣化する事もなく、信頼性が高く、応答時間の短 かいECDセルを製造する事ができる。更に現在 の電極製造技術で容易に製造し得る程度の精度で、 理想的な電極構造が得られるので、量産性にも優 れている。

4. 図面の簡単な説明

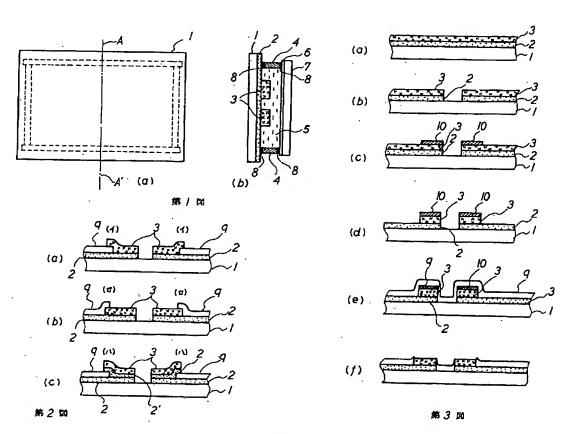
第1図(a)は従来のECDの基本的構成を示す平 面図、第1図(b)は第1図(a)においてA - Á間で切 断した断面図、第2図(a)~(c)は従来の表示電極構 造を示す断面図、第3図(a)~(f)は第2図(a)~(c)に 生じた欠点を除くために改良された表示電極形成 法の工程を示す断面図、第4図(a)~(h)は本発明の 一実施例の表示電極を得るための製造工程を示す 断面図、第5図(a)(b)は従来の表示電極製造により 製造されたECDセルの初期応答時間の分布を示 す説明図、第5図(c)(d)は本発明による実施例の ECDセルの初期応答時間の分布を示す説明図で ある。

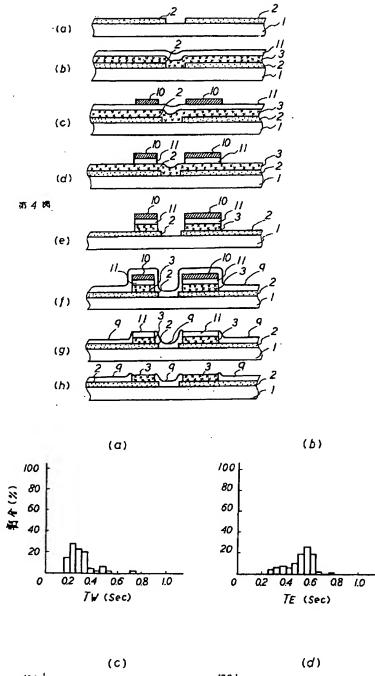
1 ··· 表示用透明基板、 2 ··· 透明電極、 8 ··· E C 膜(無定形酸化タングステン)、4…スペー

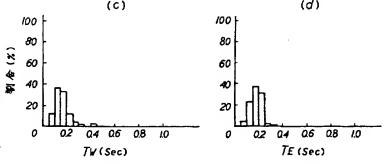
特開昭 56-106223(4)

5 …電解液、 6 …対向電極、 7 …背面基板、 8 … 接着剤、9…保護絶縁膜、10…エツチングレジ スト、11…EC膜の保護膜。

代理人 弁理士







第5页